

În data de 10 martie 2017, ora 9:00, în sala III-28, va avea loc etapa locala a concursului internațional

***Modules and Assemblies***

***TIE - Design of Electronic***

Obiectivul concursului este acela de a verifica cunoștințele de proiectare a modulelor electronice în medii de proiectare asistată (OrCAD, PADS, Altium, Eagle, etc), accentul fiind pus pe proiectarea circuitelor imprimate (PCB).

Primii trei clasati vor fi calificați pentru participarea în finala ce va avea loc în Iași, în perioada 25-27 aprilie 2017.

Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul [www.tie.ro](http://www.tie.ro) . Persoana de contact: asist. dr.ing.

[Constantin Barabașa](#) .

{backbutton}